

公司代码：688362

公司简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司
2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

2023 年，受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和行业周期性波动等多重负面因素影响，以消费电子为代表的终端市场整体需求疲软，半导体行业需求出现较大波动，整体出现周期性下行。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据，2023 年全球半导体市场规模估计为 5,201 亿美元，同比下降 9.4%，较 2022 年出现下滑。作为专注于中高端先进封测领域的封测企业，公司努力克服整体行业下行的不利影响，持续关注客户需求，围绕客户提供全方位、高质量服务，通过增强新客户拓展力度、加强新产品导入力度、提升产品品质、缩短供货周期、降低产品成本等多种方式，提升客户满意度和自身竞争力，2023 年公司稼动率整体呈稳定回升趋势。在公司全体员工的持续努力下，公司克服了多种不利因素影响，报告期内，公司实现营业收入 239,084.11 万元，较上年同期增长 9.82%；但由于下游客户整体订单仍较为疲软，部分产品线订单价格承压，导致公司毛利率较去年同期仍有所下降；同时，公司二期项目建设有序推进，公司人员规模持续扩大，人员支出及二期筹建费用增加，使得管理费用同比增长 71.97%；综合导致公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润同比下滑 167.48%。公司预计 2024 年营收规模将持续提升，由此带来的规模效应亦会对盈利能力产生正面影响，但若未来半导体产业持续低迷或公司投资项目产能爬坡不及预期，公司业绩可能出现不及预期或亏损的风险。

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-93,387,886.95元，截至2023年12月31日，公司母公司实现可供分配利润为人民币

322,542,911.80元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等的相关规定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司的经营情况和未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司审慎研究讨论，公司2023年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2023年年度利润分配预案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 甬矽电子 | 688362 | 不适用 |

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 李大林 | 咎红 |
| 办公地址 | 浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号 | 浙江省余姚市中意宁波生态园兴舜路22号 |
| 电话 | 0574-58121888-6786 | 0574-58121888-6786 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@forehope-elec.com | zhengquanbu@forehope-elec.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司主要从事集成电路的封装和测试业务，为集成电路设计企业提供集成电路封装与测试解决方案，并收取封装和测试服务加工费。公司封装产品主要包括“高密度细间距凸点倒装产品（FC类产品）、系统级封装产品（SiP）、扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）、微机电系统传感器（MEMS）”4大类别。下游客户主要为集成电路设计企业，产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片、工业类和消费类产品等领域。

公司于 2017 年 11 月设立，从成立之初即聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，车间洁净等级、生产设备、产线布局、工艺路线、技术研发、业务团队、客户导入均以先进封装业务为导向。报告期内，公司全部产品均为 QFN/DFN、WB-LGA、WB-BGA、Hybrid-BGA、FC-LGA 等中高端先进封装形式，并在系统级封装（SiP）、高密度细间距凸点倒装产品（FC 类产品）、大尺寸/细间距扁平无引脚封装产品（QFN/DFN）等先进封装领域具有较为突出的工艺优势和技术先进性。

公司为了保持先进封装技术的先进性和竞争优势，在技术研发和产品开发布局上，一方面注重与先进晶圆工艺制程发展相匹配，另一方面注重以客户和市场需求为导向。结合半导体封测领域前沿技术发展趋势，以及物联网、5G、人工智能、大数据等应用领域对集成电路芯片的封测需求，公司陆续完成了倒装和焊线类芯片的系统级混合封装技术、5 纳米晶圆倒装技术等技术的开发，并成功实现稳定量产。同时，公司已经掌握了系统级封装电磁屏蔽（EMI Shielding）技术、芯片表面金属凸点（Bumping）技术、Fan-in 技术，并积极开发 Fan-out、2.5D/3D 等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸 FC-BGA 封装技术等，为公司未来业绩可持续发展积累了较为深厚的技术储备。

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司主营业务为集成电路的封装与测试，并根据客户需求提供定制化的封装技术解决方案。客户提供未进行封装的晶圆裸片，公司根据客户要求的封装类型和技术参数，将芯片裸晶加工成可直接装配在 PCB 电路板上的芯片产品。封装完成后，公司会根据客户要求，对芯片产品的电压、电流、时间、温度、电阻、电容、频率、脉宽、占空比等参数进行专业测试。公司完成晶圆裸片的封装和芯片测试后，将芯片成品交付给客户，获得收入和利润。

（1）生产模式

公司主要专注于中高端封装和测试产品的生产，并配备了专业的高精度自动化生产设备。公司拥有专业的工程技术和生产管理团队，可以根据客户提出的各种封装测试要求及时做出响应，并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。由于不同的封装种类在生产制程上存在差异，公司为了便于生产管理，同时也为了提高生产效率和产品良率，在柔性生产模式的基础上，按照封装种类对生产线进行划分。

（2）采购模式

公司采购处负责全部生产物料和生产设备的采购，采购处下设材料采购部和设备采购部，材料采购部根据公司生产所需，负责材料（直接材料、间接材料、包装材料）采购。此外，当公司制程能力不足或产能不足时，材料采购部还负责相应的外协服务采购；设备采购部根据公司生产所需以及日常耗用情况，负责设备、备品备件、耗材、工装模具等的采购。

2、销售模式

公司以直接销售为主，主要下游客户为芯片设计公司。公司接受芯片设计客户的委托订单，对客户晶圆裸片提供封装加工和成品测试服务。

除直接销售外，报告期内公司部分数字货币领域封测产品采取代理销售模式，即专门的供应链服务公司（即代理公司）同数字货币矿机生产企业签署封装测试服务协议，公司同代理公司签署封装和测试委托加工合同或公司与代理公司及矿机芯片企业签署三方协议，并同服务公司结算，封装测试好的芯片直接发给数字货币矿机芯片企业或由其自提。公司部分数字货币类产品采取代理销售模式，一方面是因为部分数字货币矿机芯片企业更多侧重于数字货币矿机整机的销售，相对缺乏半导体产业链的运营经验，需要专业的供应链服务公司提供产能预定、订单管理等运营服务；另一方面是因为数字货币价格波动巨大，矿机芯片客户订单量波动较大，为了降低客户管理成本和经营风险，公司直接同供应链服务公司进行结算。

3、研发模式

公司主要采用自主研发模式，建立了研发项目管理制度以及专利管理制度，并具有完善的研发投入核算体系。公司设有研发工程中心，下辖材料开发处、产品研发处、设计仿真处、工艺研发处、测试工程开发处和工程实验室。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 公司所属行业及确定所属行业的依据

公司主营业务为集成电路的封装和测试。根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”；根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”下属的“集成电路制造（C3973）”。公司业务细分行业为集成电路封装和测试业。

(2) 行业的发展阶段与基本特点

20 世纪 70 年代开始，随着半导体技术日益成熟，晶圆制程和封装工艺进步日新月异，一体化的 IDM 公司逐渐在晶圆制程和封装技术方面难以保持技术先进性。为了应对激烈的市场竞争，大型半导体 IDM 公司逐步将封装测试环节剥离，交由专业的封测公司处理，封测行业变成集成电路行业中一个独立子行业。

20 世纪 90 年代，随着全球化进程加快、国际分工职能深化，以及集成电路制程难度的不断提高，集成电路产业链开始向专业化的分工方向发展，逐渐形成了独立的半导体设计企业、晶圆制造代工企业和封装测试企业。在半导体产业转移、人力资源成本优势、税收优惠等因素促进下，全球集成电路封测厂逐渐向亚太地区转移，目前亚太地区占全球集成电路封测市场大约 80% 的份额。

2023 年，受地缘政治、全球经济增速放缓等多种因素影响，全球半导体行业增速大幅放缓。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据，2023 年全球半导体市场规模估计为 5,201 亿美元，同比下降 9.4%。2023 年初全球半导体销售低迷，下半年销售额有所回升。第四季度销售额为 1460 亿美元，比 2022 年第四季度总销售额增长 11.6%，比 2023 年第三季度总销售额增长 8.4%。摩尔定律降本收敛，先进封装接棒助力 AI 浪潮。芯片依靠制程微缩带动单位性能成本的快速下降，带动半导体产业蓬勃大发展。芯片制程步入 3nm 及以下制程，摩尔定律降本效应大幅收敛，先进封装乘势而起。前道制程微缩抑或是先进封装均为在单位面积内堆叠更多芯片来获得更强的性能。先进封装内涵丰富，包括倒装焊、扇入/扇出封装、晶圆级封装、2.5D/3D 封装、Chiplet 等一系列概念，本质均为提升 I/O 密度。根据 Yole 数据，2023 年全球封测市场规模为 857 亿美元，其中先进封装占比 48.8%。通用大模型、AI 手机及 PC、高阶自动驾驶的发展均要求高性能算力，先进封装作为提升芯片性能的有效手段有望加速渗透与成长。根据市场调研机构 Yole 数据预测，全球先进封装市场规模将由 2022 年的 443 亿美元，增长到 2028 年的 786 亿美元，年复合成长率为 10.6%。此外，先进封装的市场比重将逐渐超越传统封装，成为封测市场贡献主要增量。

近年，全球半导体产业链向国内转移，封测产业已成为我国半导体的强势产业，市场规模持续向上突破。中商产业研究院发布《2024-2029 全球及中国集成电路封装行业研究及十四五规划分析报告》显示，2022 年中国集成电路封测销售规模 2995.1 亿元，同比增长 8.4%。中商产业研究院分析师预测，2024 年有望达 3368.52 亿元。



数据来源：中国半导体行业协会、中商产业研究院整理

(3) 主要技术门槛

在集成电路制程方面，“摩尔定律”认为集成电路上可容纳的元器件的数目，约每隔 18-24 个月便会增加一倍，性能也将提升一倍。长期以来，“摩尔定律”一直引领着集成电路制程技术的发展与进步，自 1987 年的 1 μ m 制程至 2015 年的 14nm 制程，集成电路制程迭代一直符合“摩尔定律”的规律。但 2015 年以后，集成电路制程的发展进入了瓶颈，7nm、5nm、3nm 制程的量产进度均落后于预期。随着台积电宣布 2nm 制程工艺实现突破，集成电路制程工艺已接近物理尺寸的极限，集成电路行业进入了“后摩尔时代”。

“后摩尔时代”制程技术突破难度较大，工艺制程受成本大幅增长和技术壁垒等因素影响，上升改进速度放缓。根据市场调研机构 IC Insights 统计，28nm 制程节点的芯片开发成本为 5,130 万美元，16nm 节点的开发成本为 1 亿美元，7nm 节点的开发成本需要 2.97 亿美元，5nm 节点开发成本上升至 5.4 亿美元。由于集成电路制程工艺短期内难以突破，通过先进封装技术提升芯片整体性能成为了集成电路行业技术发展趋势。

封测企业需要朝着先进封装技术的发展方向，不断向晶圆级封装领域和系统级封装领域发展，不断进行技术创新、开发新产品才能适应市场变化，顺应集成电路下游应用市场集成化、小型化、智能化的发展趋势。封装领域不断涌现出诸如 2.5D/3D/POP 等新兴封装类型以及先进封装技术，这对于封装测试企业在新产品的研发、品质、测试方面提出了苛刻的要求，技术门槛越来越高。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

甬矽电子专注于中高端先进封装和测试业务，报告期内，公司已经与多家行业内知名 IC 设计企业建立了稳定的合作关系。公司为国家高新技术企业，2020 年入选国家第四批“集成电路重大项目企业名单”，先后被授予“浙江省科技小巨人”、“浙江省电子信息 50 家成长性特色企业”、“浙江省创造力百强企业”、“浙江省上云标杆企业”“宁波市制造业‘大优强’培育企业”、“宁波市数字经济十佳企业”、“余姚市人民政府质量奖”、“2022 年度宁波市管理创新提升五星级企业”、“2022 年宁波市研发投入百强”等多项荣誉。公司研发中心被认定为“浙江省高新技术企业研究开发中心”公司“年产 25 亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”被评为浙江省重大项目。

根据集微咨询 (JW Insight) 发布的 2023 年中国大陆半导体封测代工企业专利创新二十强榜单，公司排名第 8。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着半导体制程的不断演进，工艺已接近瓶颈，以及芯片架构优化的限制，未来几年处理器性能的发展将逐步减慢，摩尔定律也将逐渐失效。因此，以 Chiplet 理念为代表的先进封装的技术应用将成为提高芯片性能的一种重要途径。Chiplet 是指将一类满足特定功能的 die（裸片），通过 die-todie 内部互联技术实现多个模块芯片与底层基础芯片封装在一起，形成一个系统芯片，以实现一种新形式的 IP 复用。Chiplet 是将原本一块复杂的 SoC 芯片，从设计时就按照不同的计算单元或功能单元对其进行分解，然后每个单元选择最适合的工艺制程进行制造，再将这些模块化的裸片互联起来，通过先进封装技术，将不同功能、不同工艺制造的 Chiplet 封装成在同一颗芯片内。目前而言，实现 Chiplet 的技术方式包括 2.5D、3D 等多种形式，如台积电、日月光等全球主要的封装厂或晶圆代工厂均已经或正在开发相关的封装形式，在先进制程受限的情况下，相关技术将有望成为我国集成电路封测行业新的突破口。Chiplet 技术的发展将大大推动先进封装的市场发展。

长期来看，全球及中国集成电路产业仍将持续增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测 2024 年，全球半导体市场将蓬勃发展，预计增长 13.1%，估值将达到 5880 亿美元；从区域角度看，所有市场都将在 2024 年持续扩张，特别是美洲和亚太地区，预计将实现两位数的同比大幅增长。根据 Yole 预测，全球先进封装市场预计将在 2019-2025 年间以 6.6% 的复合年增长率增长，到 2025 年将达到 420 亿美元；同时，与传统封装相比，先进封装的应用正不断扩大，预计到 2026 先进封装将占到整个封装市场规模的 50% 以上。

我国是全球最大的集成电路需求市场，特别是对价值较高的高端芯片进口依赖较大，芯片进口金额远超出口金额，这表明我国在芯片领域存在较大的贸易逆差。根据国家统计局发布的 2023 年国民经济和社会发展统计公报，我国 2023 年全年集成电路产量 3,514.4 亿块，比上年提升 6.9%；全年集成电路出口 2,678 亿个，比上年下降 1.8%，金额为 9,568 亿元，比上年下降 5.0%，在我国主要商品出口中金额排名第四；集成电路进口 4,796 亿个，比上年下降 10.8%、金额为 24,591 亿元，比上年下降 10.6%，在我国主要商品进口中金额排名第一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | 调整后 | 调整前 |
| 总资产 | 12,330,906,165.46 | 8,320,726,323.62 | 8,318,700,069.06 | 48.20 | 4,632,600,117.09 | 4,632,186,187.28 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,448,597,504.62 | 2,554,143,218.39 | 2,553,847,009.77 | -4.13 | 1,373,119,281.15 | 1,373,092,019.81 |
| 营业收入 | 2,390,841,120.27 | 2,176,992,689.58 | 2,176,992,689.58 | 9.82 | 2,054,615,247.43 | 2,054,615,247.43 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 2,382,294,225.34 | 2,154,873,373.35 | 2,154,873,373.35 | 10.55 | 2,041,103,021.00 | 2,041,103,021.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -93,387,886.95 | 138,400,419.38 | 138,131,472.10 | -167.48 | 322,102,165.93 | 322,074,904.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -161,909,756.67 | 59,308,286.37 | 59,039,339.09 | -373.00 | 292,607,936.58 | 292,580,675.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071,479,586.66 | 899,615,766.86 | 899,615,766.86 | 19.10 | 818,627,146.81 | 818,627,146.81 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -3.75 | 9.02 | 9.00 | 减少12.77个百分点 | 33.64 | 33.64 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.23 | 0.39 | 0.39 | -158.97 | 1.05 | 1.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.23 | 0.39 | 0.39 | -158.97 | 0.93 | 0.93 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.07 | 5.59 | 5.59 | 增加0.48个百分点 | 4.72 | 4.72 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 424,645,413.14 | 558,068,011.41 | 648,393,145.75 | 759,734,549.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -49,869,944.15 | -29,028,939.84 | -41,049,294.47 | 26,560,291.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -69,100,749.43 | -44,658,794.82 | -49,608,981.77 | 1,458,769.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,017,056.85 | 253,616,163.44 | 175,185,191.05 | 643,695,289.02 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | | 13,980 |
|-------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|------------------------------|--------------------|--------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | | 12,763 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | | | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | | | | | | | | 不适用 |
| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股 数量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 包含转融 通借出股 份的限售 股份数量 | 质押、标记 或冻结情 况 | | 股东 性质 |
| | | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-------|------------|------------|---|---|---------|
| 浙江甬顺芯电子有限公司 | 0 | 74,210,000 | 18.20 | 74,210,000 | 74,210,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 浙江朗迪集团股份有限公司 | 0 | 31,000,000 | 7.60 | 0 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 显鎡(上海)投资管理有限公司—海宁齐鑫炜邦股权投资合伙企业(有限合伙) | -5,676,800 | 23,323,200 | 5.72 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波鲸益创业投资合伙企业(有限合伙) | -2,800,000 | 20,700,000 | 5.08 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中意宁波生态园控股集团有限公司 | -2,172,000 | 20,618,000 | 5.06 | 0 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 王顺波 | 0 | 16,000,000 | 3.92 | 16,000,000 | 16,000,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 15,250,000 | 3.74 | 15,250,000 | 15,250,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 14,530,000 | 3.56 | 14,530,000 | 14,530,000 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波开投瀚润投资管理合伙企业(有限合伙)—宁波瀚海乾元股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 10,000,000 | 2.45 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0 | 9,845,000 | 2.42 | 9,845,000 | 9,845,000 | 无 | 0 | 其他 |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1. 上述股东中，浙江甬顺芯电子有限公司系宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；浙江甬顺芯电子有限公司、宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人王顺波控制的企业。2. 除此之外，公司未知上述前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

存托凭证持有人情况

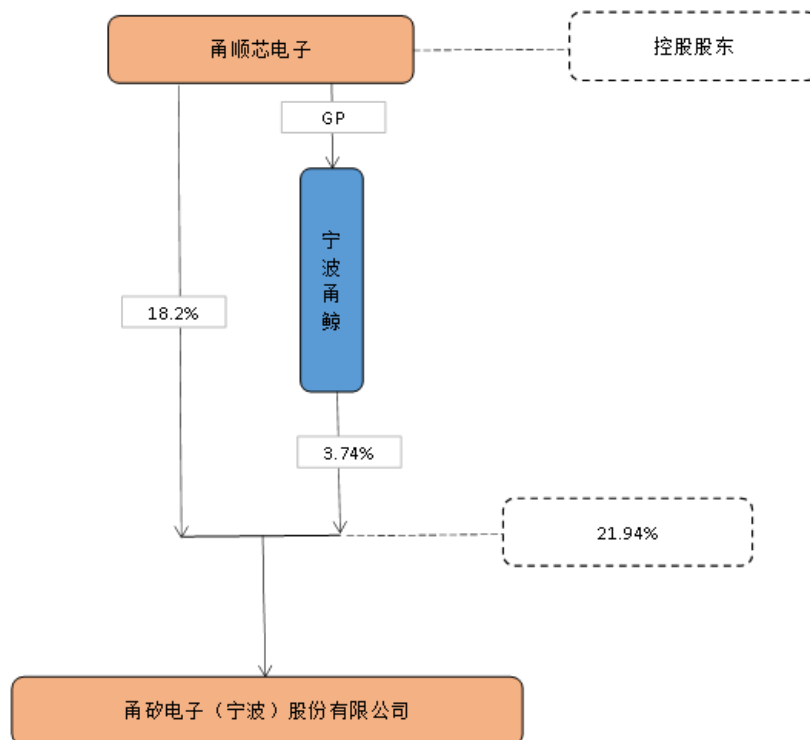
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

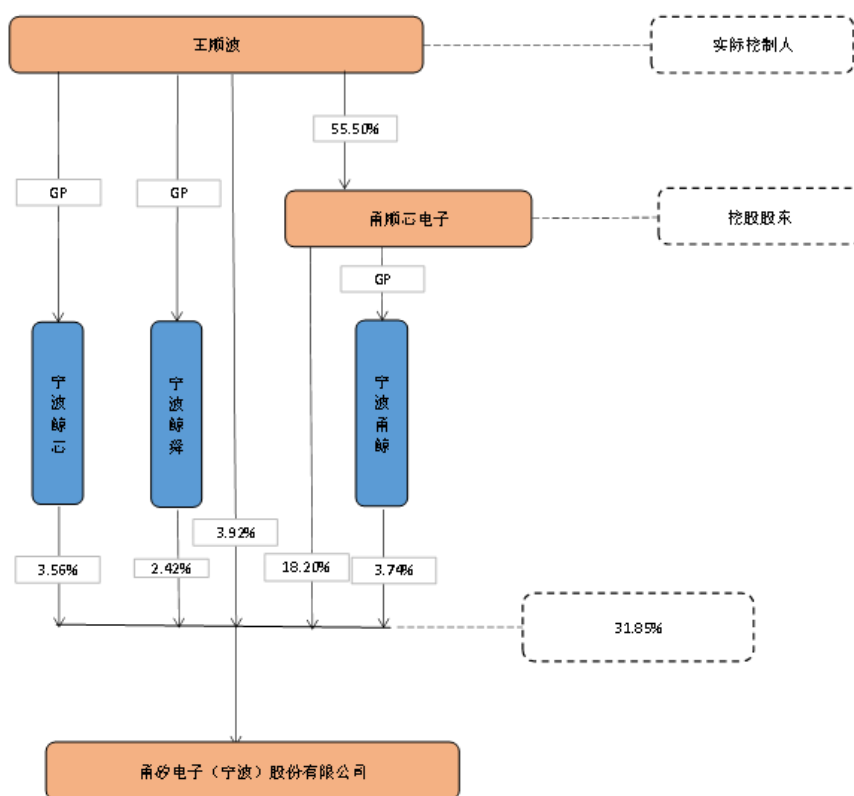
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期，公司实现营业收入 239,084.11 万元，同比增加 9.82%；公司归属上市公司股东的净利润为-9,338.79 万元，同比减少 167.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16,190.98 万元，同比减少 373%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用